

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（）
参与单位名称	<u>2026年1月14日</u> Boyu Capital 、 Marshall Wace 、 AllM Investment 、 WT Asset Management、 JPMorgan Asset Management、 T.Rowe Price 等 <u>2026年1月15日</u> Infini Capital 、 LMR Partners 、 Neuberger Berman 、 Balyasny Asset Management、 Valliance Asset Management 等 <u>2026年1月16日</u> Mirae Asset、 Hel Ved、 Janchor Partners、 Aspex Management 等
时间	2026年1月14日、2026年1月15日、2026年1月16日
调研方式	线下会议
公司接待人员姓名	公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民） 公司董事、董事会秘书、人事行政高级副总裁：石雯丽
投资者关系活动主要内容介绍	

公司介绍

芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processing IP）这六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AI PC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。

为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。

基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。

芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。此外，根据 IPnest 在 2025 年的统计，从半导体 IP 销售收入角度，芯原是 2024 年中国大陆排名第一、全球排名第八的半导体 IP 授权服务提供商；2024 年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据 IPnest 的报告和企业公开数据，在全球排名前十的 IP 企业中，芯原的 IP 种类排名前二。

根据公司披露的《关于新签订单的自愿性披露公告》，2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日，公司 2025 年第四季度新签订单 24.94 亿

	<p>元，较去年第四季度全期大幅增长 129.94%，较今年第三季度全期进一步增长 56.54%，继 2025 年第二、三季度单季度新签订单屡创历史新高后，再创历史单季度新高，将为公司未来营业收入增长提供有力的保障。截至 2025 年 12 月 25 日，公司第四季度新签订单金额中绝大部分为一站式芯片定制业务订单，AI 算力相关订单占比超 84%，数据处理领域订单占比近 76%。上述新签订单数据为公司内部统计，公司业绩情况以公司最终披露的定期报告为准。</p>
<p>交流问答</p>	<p>问题：请问公司如何展望未来 AI 云侧和端侧的增长机会？</p> <p>回复：公司针对 AI 端侧、云侧均拥有丰富的半导体 IP 和相关技术平台积累。例如，在 AI 端侧应用上，芯原已经深耕多年。芯原全球领先的 NPU IP，已经在 91 家客户的 140 多款芯片中获得采用，覆盖了服务器、汽车、智能手机、可穿戴设备等 10 多个市场领域，相关芯片出货已经近 2 亿颗。目前，芯原的 NPU 可以为移动端大语言模型推理提供超过 40 TOPS 算力，并且已经在知名企业的手机和平板电脑中量产出货。此外，公司的 AI-ISP 芯片定制方案也已经在知名厂商的智能手机中量产。在云侧，比如数据中心和服务器领域，芯原的 VPU、NPU 和 GPGPU IP 都获得了广泛应用；此外，公司面向汽车和边缘 AI 服务器推出了可扩展的高性能 GPGPU-AI 计算 IP，并且正在与多家领先的 AI 计算客户深度合作。</p> <p>受到 AI 云侧、端侧需求带动，公司订单快速增长。截至 2025 年 12 月 25 日，公司第四季度新签订单 24.94 亿元，再创历史单季度新高，其中 AI 算力相关订单占比超 84%。</p> <p>问题：请问公司如何看待 AI/AR 眼镜等增量市场的发展，以及公司在该领域有哪些技术布局？</p>

回复：在边缘人工智能终端产品中，以 AI/AR 眼镜为代表的智慧可穿戴设备被认为是继智能手机之后的下一个十亿级出货量的产品，这类设备可搭载更为自然的人机交互界面和越来越强大的本地 AI 处理能力，创新人们的数字生活和社交。芯原拥有面向相关领域的极低功耗高性能芯片设计平台，可以打造适应不同功率模式的产品，满足超轻量实时在线、低功耗以及全性能的全场景应用。目前，在 AI/AR/VR 眼镜领域，公司已为某知名国际互联网企业提供 AR 眼镜的芯片一站式定制服务，此外还有数家全球领先的 AI/AR/VR 客户正在与芯原进行合作。

问题：请问公司目前与云服务提供商、互联网厂商等客户的合作情况如何？

回复：近年来，互联网公司、云服务提供商、车企等系统厂商因成本、差异化竞争、创新性、掌握核心技术、供应链可控等原因，越来越多地开始设计自有品牌的芯片。这类企业因为芯片设计能力、资源和经验相对欠缺的原因多寻求与芯片设计服务公司进行合作。随着公司提供硬件和软件完整系统解决方案的能力不断提升，迎合了互联网企业、云服务提供商和车企等系统厂商客户的需求，2025 年前三季度，来自上述系统厂商客户的收入占比 40.36%；截至三季度末，公司在手订单中 83.52%来自于上述系统厂商客户。

问题：请问公司预计最新的在手订单情况如何？

回复：截至今年三季度末，公司在手订单 32.86 亿元，已连续八个季度保持高位。公司 2025 年第三季度末在手订单中，一站式芯片定制业务在手订单占比近 90%，且预计一年内转化的比例约为 80%，为公司未来营业收入增长提供了有力的保障。截至 12 月 25 日，公司第四季度新签订单 24.94 亿元，再次创下历史新高，在手订单预计将保持高位。

问题：请问公司在智驾领域有哪些技术布局？

回复：近年来，公司聚焦快速增长的汽车电子领域，芯片设计流程已获得 ISO 26262 汽车功能安全管理体系认证，可从芯片和 IP 的设计实现、软件开发等方面，为全球客户满足功能安全要求的车载芯片提供一站式定制服务；此外，芯原还推出了功能安全（FuSa）SoC 平台的总体设计流程，以及基于该平台的 ADAS 功能安全方案，并搭建了完整的自动驾驶软件平台框架。

基于上述技术布局，芯原已经积累了为汽车厂商设计高性能车规 ADAS 芯片的相关经验，例如为某知名新能源汽车厂商提供基于 5nm 车规工艺制程的自动驾驶芯片定制服务，其中集成了芯原的多个半导体 IP，并符合 ISO 26262 功能安全标准，性能全球领先。目前芯原正在与一系列汽车领域的关键客户进行深入合作，并积极推进智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发，以在智慧出行领域取得更好的发展机会。